



HB Technology IR Book

May. 2022



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 작성 되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 '예측정보' 는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 '예측정보' 는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 '예측정보' 에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

Contents



1. **Company Overview**
2. 장비 사업 부문
3. 부품 소재 사업 부문
4. 재무현황 및 참고자료

1. Company Overview

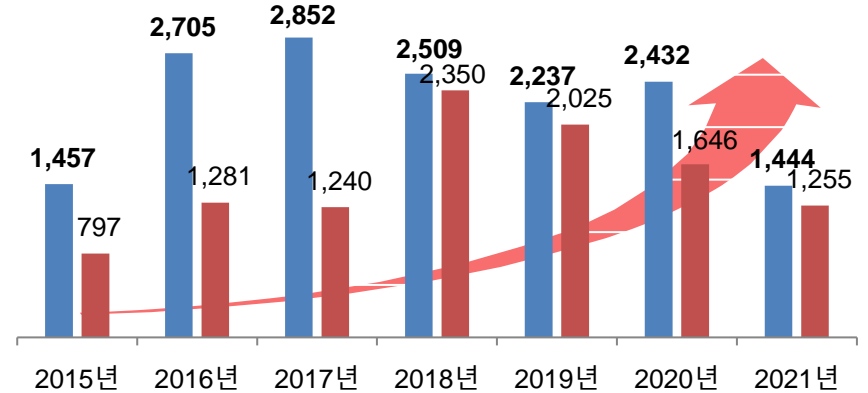
- **설립일** : 1997년 9월 2일
- **본사주소** : 충남 아산시 음봉면 산동로 87
- **대표이사** : 문성준
- **임직원수** : 433명(2022년 3월 31일 현재)
- **주요사업** : LCD/OLED용 AOI 검사장비, Laser Repair, 2차전지 검사기, LED TV용 도광판, 확산판
- **시가총액** : 약 1,800억(2022년 5월 18일 현재)
- **주가추이(2018년 1월 ~ 2022년 5월 18일)**



1. Company Overview

HB테크놀러지는 25년 동안 디스플레이관련 업종에 집중하고 있으며, 엘에스텍, HB솔루션(舊 LET) 등 활발한 M&A를 통하여 디스플레이 전문 기업으로 도약하고 있습니다. 또한 미래성장동력 확보를 위해 다양한 사업분야로 진출하고자 꾸준한 기술개발을 하고 있습니다.

매출(별도기준) 성장 추이(단위 : 억원)



※ 2021년 연결기준 매출액 1,589억원, 수출매출액 1,373억원, 비중 86.4%

회사 태동기

- **1997** 회사 설립
- **1988** 벤처기업 인증
- **2001** Inno-Biz기업 선정(중소기업청)
국내최초 모바일용 LGP 개발
- **2002** 삼성전자 협력업체 승인
ISO 9001:2000 품질경영 인증 획득(BSI)

디스플레이 전문기업으로 도약

- **2003** 삼성전자 협성회 가입
- **2009** AMOLED용 Sub-um AOI개발/수주
- **2011** 삼성전자 SQCI 1위(Display 주요부품)
대표이사 변경(문성준)
- **2012** 사명변경(HB테크놀러지)
제일모직으로부터 LCD소재사업 인수
- **2013** 엘에스텍 흡수 합병
- **2015** 제6회 디스플레이날 "산업장관 표창"
- **2017** 월드클래스300 선정
- **2018** 장비사업본부 풍세 2공장 완공
HB솔루션(舊 LET) 지분 인수

지속가능 경영기업으로 전환

- **2020** 2차전지 검사기 출하(HBT)
- **2021** HB테크놀러지 Hungary Kft. 설립
- **2021** LET, KMAC 합병(→사명 HB솔루션)
- **2022** 종속회사 HB Optics 합병

1. Company Overview

HB 그룹은 디스플레이 장비, 부품소재(도광판/확산판), 엔터테인먼트, 창업투자, 펄프무역 등 5대 주요 사업을 발전시키고 있으며, 지주회사인 (주)HB콤플과 5개 계열사, 중국, 대만, 베트남 등지에 해외 자회사를 운영하고 있습니다.

현재, HB테크놀러지, HB솔루션 2개사가 코스닥에 상장되어 있습니다.

	HB 테크놀러지	HB 솔루션
<ul style="list-style-type: none"> 설립일 위치 대표이사 임직원수⁽¹⁾ 주요 사업 시가총액⁽²⁾ 	1997년 9월 충남 아산 문성준 433명 AOI/Repair, 2차전지 검사장비, 도광판/확산판 1,800억	2001년 9월 충남 아산 이흥근, 이재원 268명 UTG Lami, 잉크젯, FoD, 점등검사기, 반도체장비 2,800억
<ul style="list-style-type: none"> 사업장 전경 		

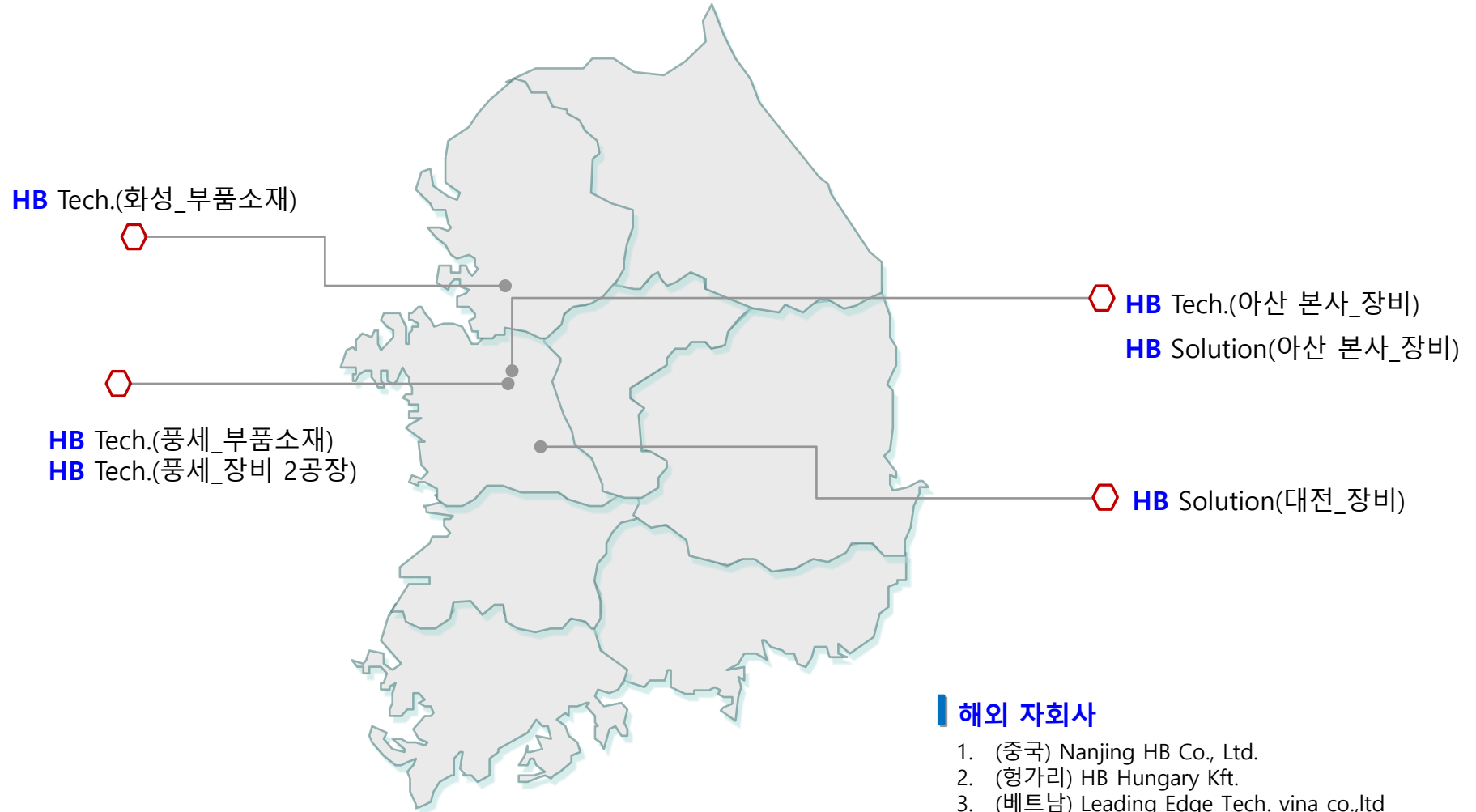
	HB 콤플	HB 인베스트먼트	HB 엔터테인먼트
<ul style="list-style-type: none"> 설립일 위치 대표이사 임직원수 주요 사업 	1975년 9월 서울 강남구 언주로 문성준 40명 펄프무역, 부동산임대	1999년 11월 서울 강남구 언주로 황유선, 박하진 16명 창업투자(벤처캐피탈)	2006년 10월 서울 강남구 언주로 문보미 22명 드라마 제작, 매니지먼트



(1) 2022년 3월 31일 기준
 (2) 2022년 5월 18일 기준

1. Company Overview

HB Tech.는 국내 4개 사업장, 해외 2개 자회사를 운영 중이고, 관계회사인 HB Solution은 국내 2개 사업장, 해외 2개 자회사를 운영 중입니다.⁽¹⁾



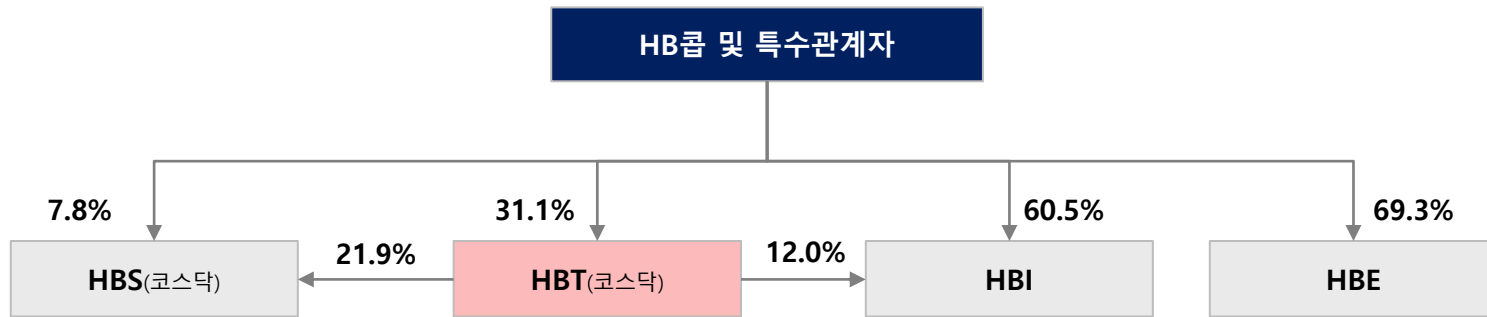
해외 자회사

1. (중국) Nanjing HB Co., Ltd.
2. (헝가리) HB Hungary Kft.
3. (베트남) Leading Edge Tech. vina co.,ltd
4. (대만) HB Solution Technology Corp.

(1) 2022년 3월말 현재

1. Company Overview

지주회사 역할을 하고 있는 HB콤플을 중심으로 안정적인 지배구조를 유지하고 있습니다.



[2022년 3월 31일 기준]

(단위: %)

출자회사	특수관계자	HB Corp.	HB Technology	HB Solution	합계
HB Corp.	100.0%	-	-	-	100.0%
HB Technology	15.2%	15.9%	-	-	31.1%
HB Solution	0.3%	7.5%	21.9%	-	29.7%
HB Entertainment	49.5%	19.8%	-	-	69.3%
HB Investment	20.5%	40.0%	12.0%	-	72.5%

(*) 해외자회사 4개社(대만, 중국(남경), 헝가리, 베트남) 제외

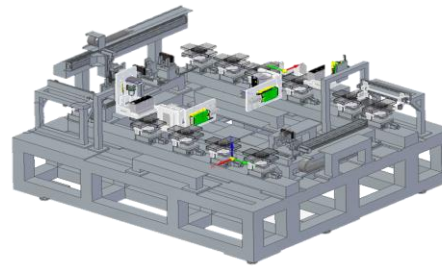
1. Company Overview

HB테크놀러지는 디스플레이 장비(AOI, Laser Repair), 2차전지 장비, LED TV 등에 사용되는 확산판과 도광판을 주요 사업부문으로 갖고 있습니다.

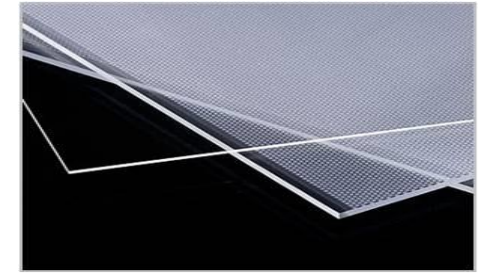
디스플레이 장비



2차전지 장비



부품소재



주요 제품

- In-line AOI
- Stand Alone AOI
- Sub Micro(0.2~0.8um) AOI
- Mask AOI
- Laser Repair
- Edge Crack AOI
- 각형 외관 검사기
- 원형 셀 검사기
- Impact CAN 외관 검사기
- 도광판(LGP)
- 확산판(DP)

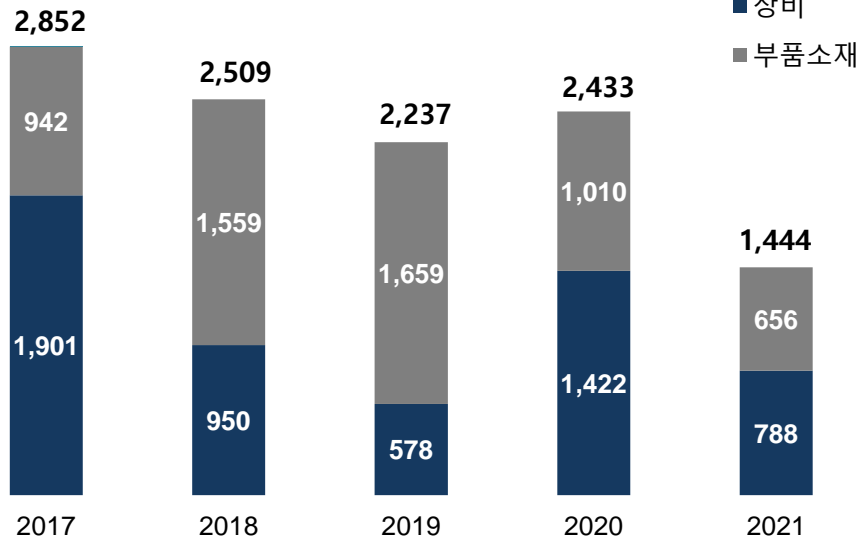
주요 Site

- HB Tech.(아산)
- HB Tech.(풍세2)
- HB Tech.(아산)
- HB Tech.(풍세2)
- HB Hungary Kft.(헝가리)
- HB Tech.(화성)
- HB Tech.(풍세1)

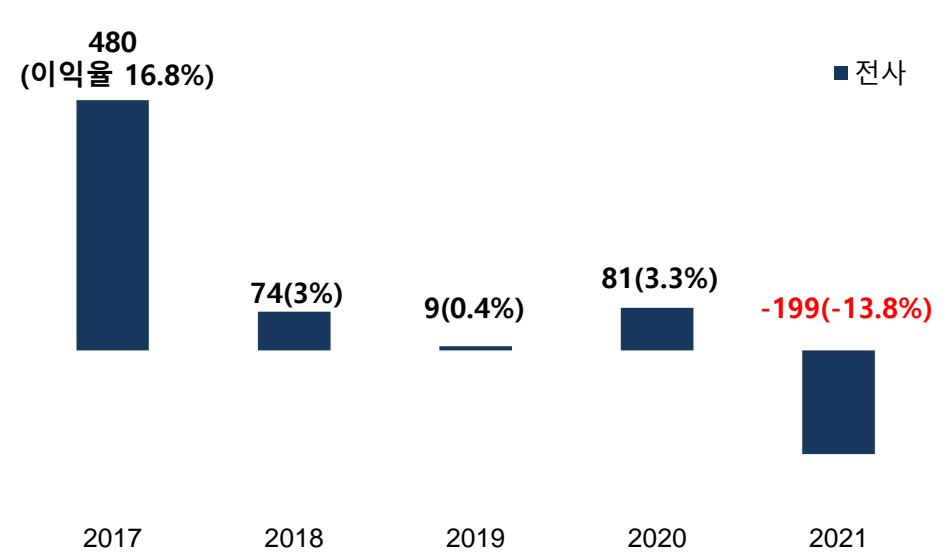
1. Company Overview

매출액 및 영업이익 추이

매출액(억원)



영업이익(억원)



장비 사업

- 차세대 디스플레이 검사기술 선행개발 추진
 - 투명전극 검사 기술, u-LED 검사 기술, QNED 정렬 검사 기술
- Deep Learning 및 AI 기술을 활용한 불량 분류 기술 강화
- 중국 남경법인의 현지 전문인력(SW, PLC) 활용도 제고를 통한 해외 셋업 비용 절감 및 대응력 강화
- 2차전지 신규 장비 Launching(원형 Cell 외관 검사기 등)

부품소재 사업

- 삼성전자 VD 사업부 內 도광판/확산판 시장 점유율 확대(21년 기준 25.0%)
- 원재료 단가 상승에 따른 판매 단가 인상 추진(10~15%)으로 수익성 제고
- 신규 재질(MS500, PS+) 적용 원판 개발
- R/S 공정 Tact time 개선을 통한 생산성 향상(압출 25% ↑, RS 40% ↑, 경면 40% ↑)

신사업 발굴 모색

- 지분투자 회사(H社) 상장 추진 中(상장예비심사 승인 완료, 6월 초 증권신고서 제출예정)
- 세종시 스마트그린 산업단지로 본사 이전 예정(토지 12,000평, '24년)
- 반도체, 2차전지 부품/소재 기업 M&A 검토 추진



1. Company Overview
2. 장비 사업 부문
3. 부품 소재 사업 부문
4. 재무현황 및 참고자료

1. 시장동향(국내)

“삼성디스플레이는 3가지 축으로 투자를 진행할 것으로 예상됨”



- OLED 산업은 스마트폰 시장 내 침투율 상승, 프리미엄 중심의 OLED TV 시장 확대로 꾸준히 성장 중
- 특히 지난해부터 태블릿, IT, XR 기기 등 신규 어플리케이션 확대가 본격화되며 IT향 OLED패널기술, 가격 경쟁력 확보를 위해 연구개발을 가속화하고, 신규 설비 투자에 나설 것으로 전망됨.



삼성디스플레이 8.5G QD-OLED 라인 양산 가동

삼성전자-LG디스플레이 WOLED TV 패널 채택 여부

출처: 하이투자증권

삼성디스플레이 IT향 8.5G RGB OLED 신규설비 투자 (15K/월, 1Q24 가동예상)

LCD TV 패널가격 상승 반전 가능성

iPhone14 신제품 출시

[iPhone향 OLED 패널 출하량] (단위: 억대)				
	21	22F	YoY	DDI
SDC	1.25	1.25	0%	LSI
LGD	0.48	0.5	0%	LX
BOE	0.15	0.45	+191%	세미콘
Total	1.89	2.25	+19%	

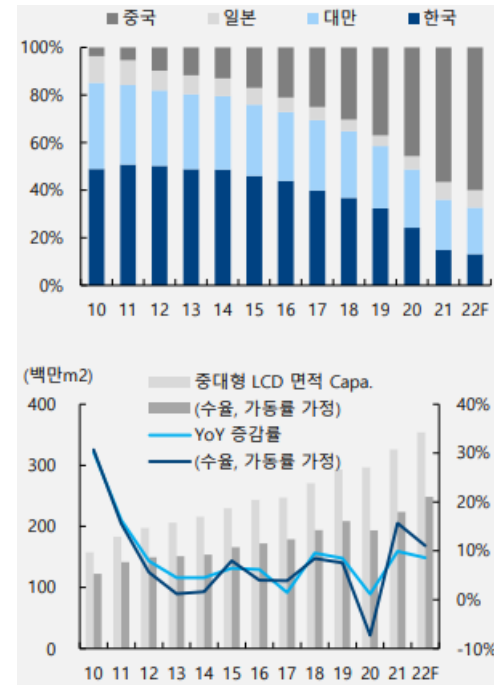
1H23 출시 예상되는 애플 VR관련 SCM 주목

1. 시장동향(해외)

“중국 업체들의 지속적인 디스플레이 설비투자는 아직 유효”

- 중국 OLED 투자는 BOE B16(8.6G), 샤먼천마 TM19가 2022년 후반에 있을 것으로 예상됨.
- BOE, CSOT, HKC 등 중국 패널업체들의 8.5세대, 10.5세대 신규 LCD Capa. 가동계획은 공격적일 것으로 예상됨.
- 2022년 중대형 LCD 공급 증감율은 중국 업체들의 신규 8.5/10.5세대 Capa. 가동으로 전년 대비 약 9% 증가할 것으로 전망됨.

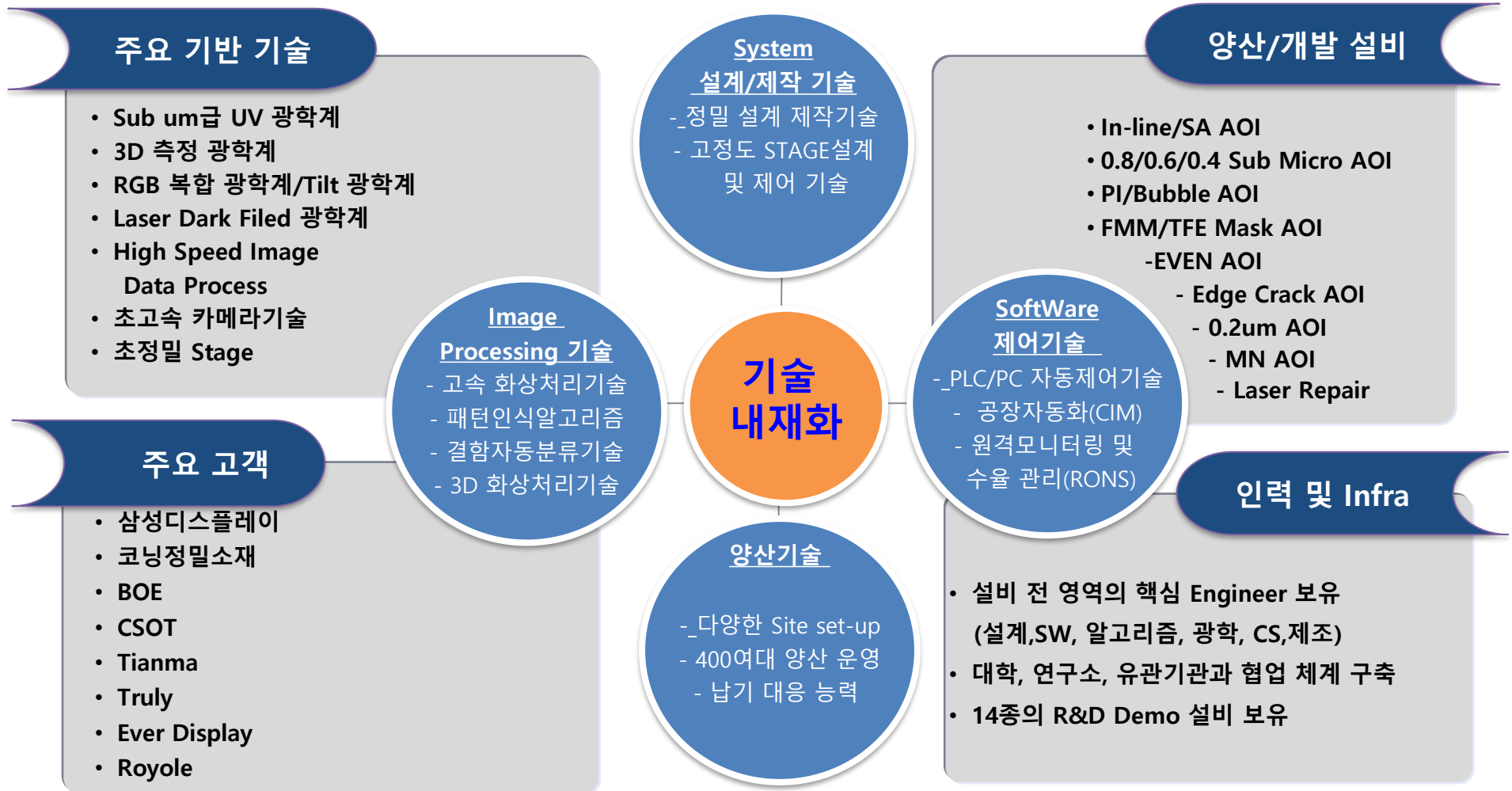
연도	업체명	Fab.	Gen	MG Size	Tech.	Capa.	가동 시점
	2021	BOE	B17	10.5	2940x3370	LCD	60K/월
CSOT		T7	10.5	2940x3370	LCD	60K/월	1Q21
HKC		Mianyang H4	8.6	2250x2600	LCD	75K/월	1Q21
		Mianyang H5	8.6	2250x2600	LCD	55K/월	2Q21
Sharp-Foxconn		Guangzhou	10.5	2940x3370	LCD	45K/월	1Q21
2022	BOE	B10	8	2200x2500	LCD	30K/월	2Q22
		B17	10.5	2940x3370	LCD	25K/월	3Q22
		B18	8	2200x2500	LCD(Oxide)	30K/월	4Q22
		B19	8.6	2290x2620	LCD	30K/월	2Q22
	CSOT	T7	10.5	2940x3370	LCD	45K/월	1Q22
		T9	8.6	2250x2600	LCD	90K/월	4Q22
	HKC	Mianyang H4	8.6	2250x2600	LCD	30K/월	1Q22
		Mianyang H5	8.6	2250x2600	LCD	27K/월	1Q22
	Sharp-Foxconn	Guangzhou	10.5	2940x3370	LCD	30K/월	4Q22



출처: 하이투자증권

2. Core Technology

R&D - 개발 - 생산 전 영역의 기술 및 인력을 내재화하고, 신기술 개발 중



3. 회사의 강점

“Display 산업의 선두주자”

시장경쟁력

- 높은 시장지배력 보유한 전공정 OLED 검사설비 Line - up
- 국내외 OLED 검사설비의 표준

수익성

- 우수한 기술력으로 인한 진입장벽
- 기술선도로 원가경쟁력 확보

산업의 성장성

- Global Market Premium급 Display 시장 확대
- 중국 OLED 투자 증가에 따른 고객사 다양화



기술 Synergy

Global Display
검사장비 그룹



영업 Synergy

중국 등 Global
고객사 확보



원가 Synergy

원재료 공동구매 등
원가절감 지속

HB 그룹

Display 검사-계측-도포-Lamination 장비 개발 전문 그룹사



전공정 검사장비 전문



모듈 검사&Lamination 장비 선도

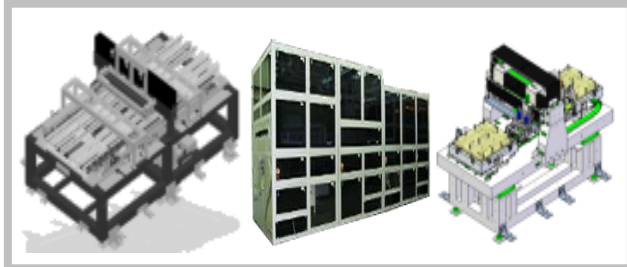


공정 검사 및 계측 장비 특화

4. 주요 사업 item

HB테크놀러지는 AMOLED 양산용 AOI를 세계 최초로 개발하여 국내 및 해외 디스플레이 제조업체들에게 공급하며, 시장점유율을 넓혀가고 있습니다.

AOI장비외에 사업아이템 확대를 위해, Laser Repair, PCB AOI 및 2차전지 검사장비 등으로 확대해 나아가고 있습니다.



OLED AOI (BP, MASK, EVEN)

▶ **개요**

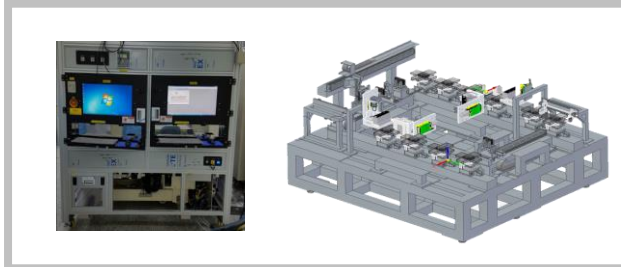
AMOLED 공정결함 검출을 위한 특화된 광학계 구성, 차별화된 알고리즘 및 고속 이미지 프로세싱 기술을 응용하여 LCD대비 고도 품질 관리 및 생산성 향상

▶ **기능**

- ✓ 포토, Strip 공정의 회로결함에 대한 In-line 구조검사
- ✓ LTPS 공정의 미세회로 및 파티클 검사
- ✓ FMM, TFE MASK 표면 불량, 이물검사, Warpage 측정
- ✓ Monomer 공정후 돌기/얼룩 구분용 2.5D검사
- ✓ Encapsulation 후 표면 이물, 파티클 검사
- ✓ Glass Back면 스크래치, 파티클 검사
- ✓ 디스플레이 substrate 최종 검사

▶ **주납품처**

삼성디스플레이



PCB AOI 및 2차전지 외관검사장비

▶ **PCB AOI**

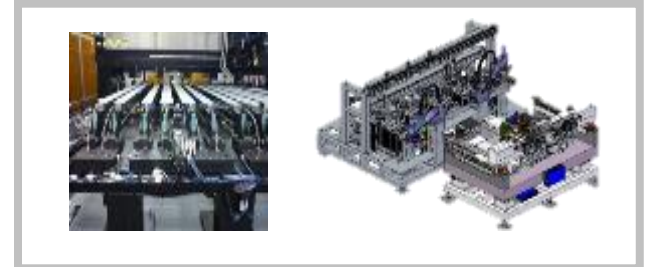
FOPLP 공정의 PCB Pattern을 검사하는 장비로 투명 PID와 박막 표면 요철로 인한 검사오류를 효과적으로 제어하고 특수 광학계를 적용하여 미세패턴 불량을 검사하는 설비

▶ **2차전지 외관검사장비**

전수 자동화 외관 검사를 통해 불량을 검사하는 장비
배터리 외부 Can 검사 및 단자부의 불량을 2D 및 3D 광학계를 통해 효과적으로 검사하는 장비

▶ **주납품처**

삼성전기, 삼성SDI



Laser Repair System(BP, Cell)

▶ **BP**

AOI 검사 이후 검출된 Defect을 레이저를 이용하여 CVC, Cutting, Drilling 등을 통하여 결점 제거 및 양품화하여 생산수율 향상에 기여

▶ **Cell**

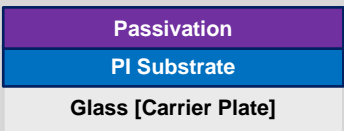
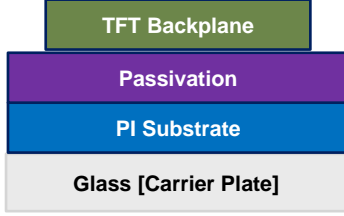
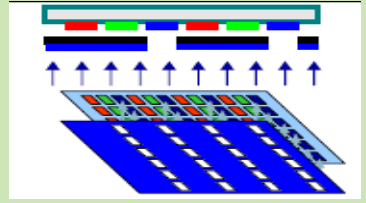
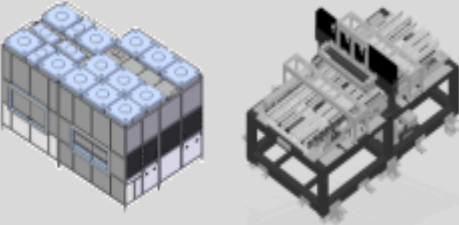


Cell 공정 후 발견되는 불량 PANNEL을 Laser 가공을 통해 양품화 시키거나 불량 수준을 약화 시켜 수율 및 품질을 향상시키는 장비

▶ **주납품처**

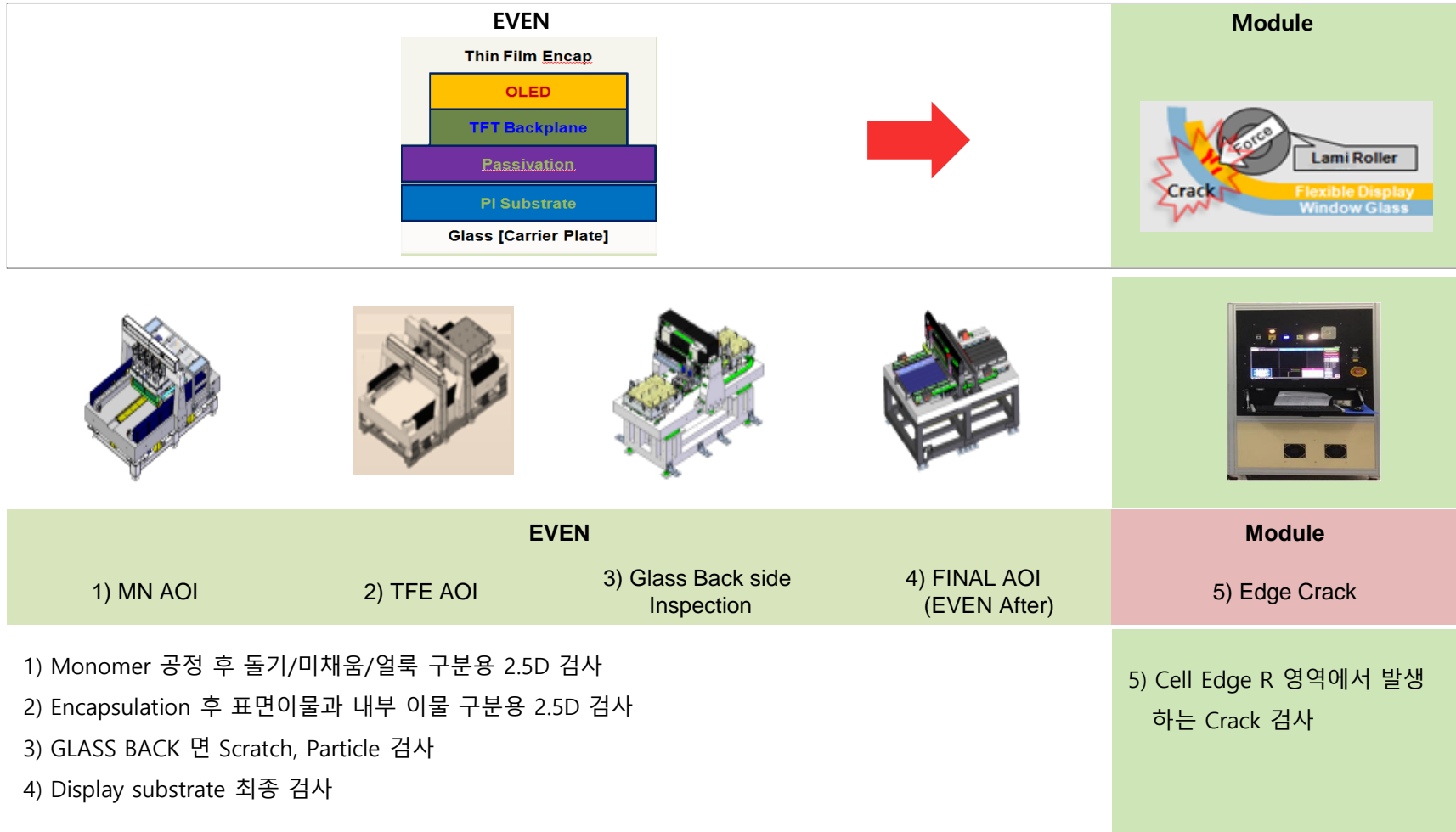
삼성 디스플레이

OLED BP, MASK, EVEN 공정의 검사 Line-up

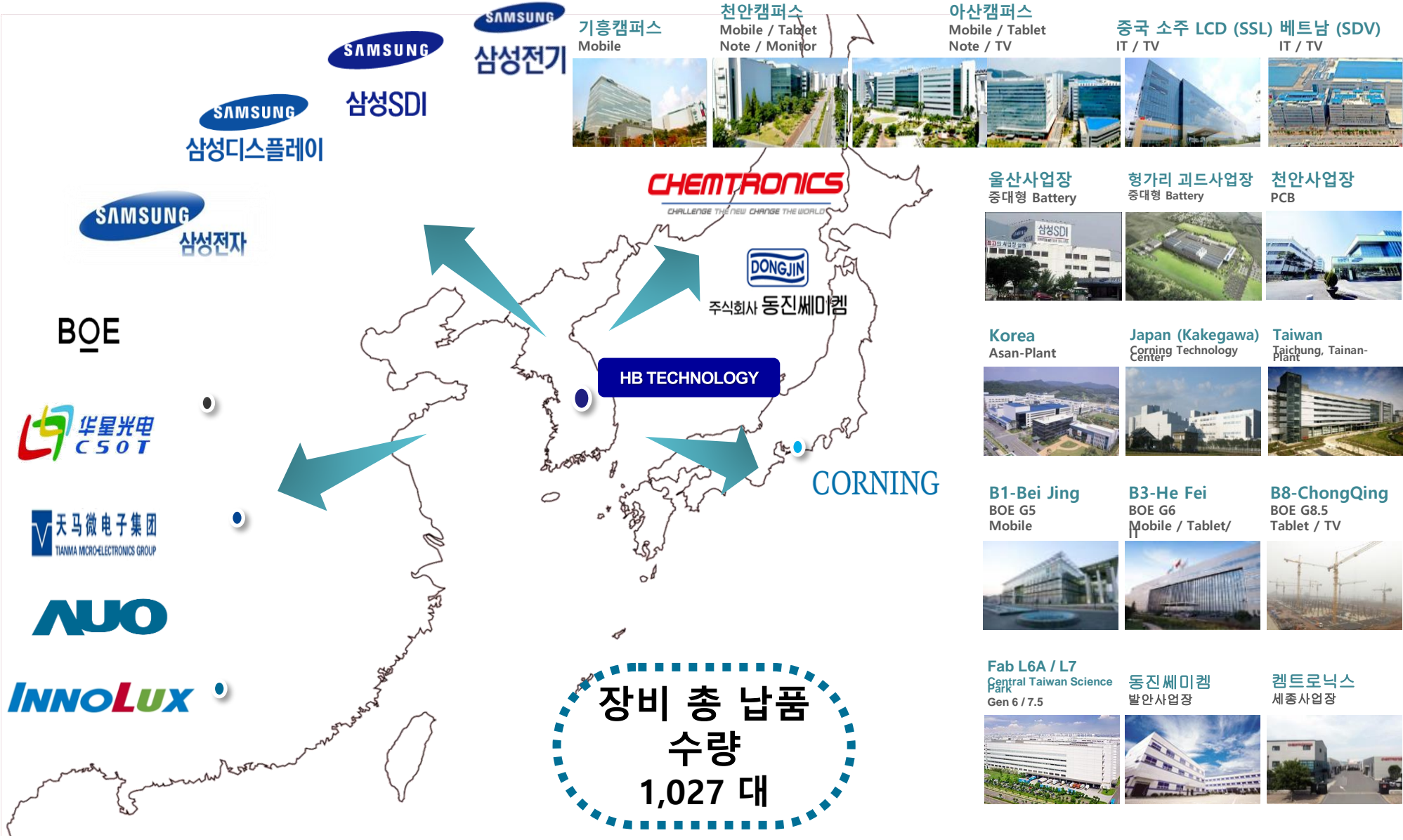
- OLED 공정 검사영역에 당사장비 폭넓게 커버, LCD 대비 검사장비 소요량 증가

<p>Flexible</p> 	<p>BP</p> 	<p>Mask</p> 
		
<p>Flexible</p> <p>1) PI 2) Bubble</p>	<p>BP</p> <p>3) ADI 4) ACI 5) 0.8um 6) 0.4um</p>	<p>Mask</p> <p>7) FMM Mask 8) TFE Mask</p>
<p>1) Flexible 기판 성형 공정 불량 검사</p> <p>2) Flexible 기판 성형 공정 이후 불량 검사</p>	<p>3) Photo 공정의 각종 회로 결함 In-Line구조 검사</p> <p>4) Strip 공정의 각종 회로 결함 In-Line 구조 검사</p> <p>5) LTPS 공정의 미세 회로 검사</p> <p>6) LTPS 공정의 미세 회로 및 파티클 검사</p>	<p>7) FMM MASK 표면 불량, 이물 검사 및 Warpage 측정</p> <p>8) TFE MASK 표면 불량, 이물 검사 및 Warpage 측정</p>

4. 주요 사업 item



5. 고객사 현황





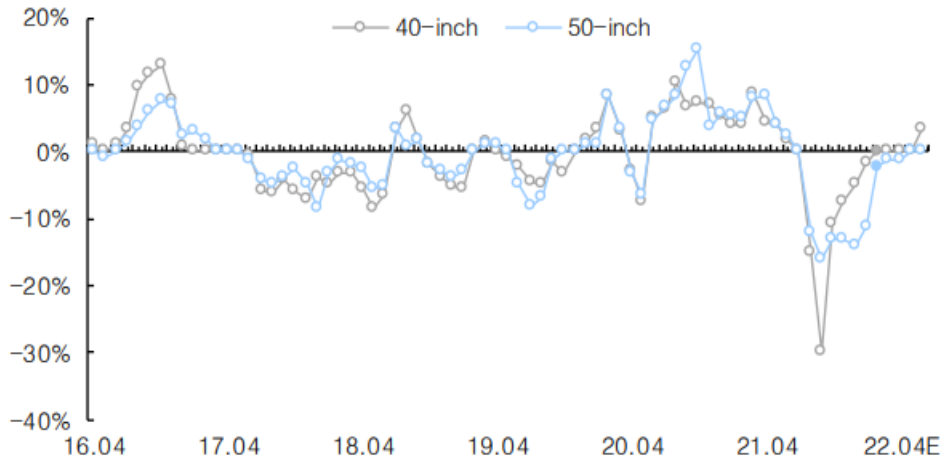
1. Company Overview
2. 장비 사업 부문
3. 부품 소재 사업 부문
4. 재무현황 및 참고자료

1. 전방시장 동향

LCD패널 수요 및 가격은 전반적인 하락세

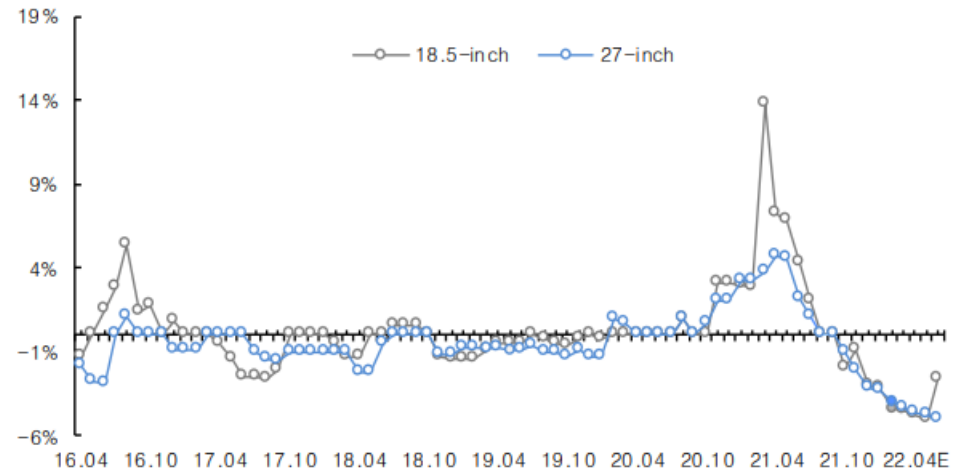
- 러시아, 우크라이나 전쟁으로 불확실성이 확대되면서 2022년 3월 기준 LCD TV용 50인치 이상 패널 가격은 하락세
- 2022년 3월 모니터 전사이즈 패널가격 하락. Set 메이커들은 '22년 수요에 대해 점점 더 보수적인 입장으로 향후 몇 개월동안 출하량은 더 낮아질 수 있음.

LCD TV 패널 가격 전월 대비 등락률 추이



자료: OMDIA, IBK투자증권

LCD 모니터 패널 가격 전월 대비 등락률 추이



자료: OMDIA, IBK투자증권

2. 주요 사업 아이템

HB테크놀러지의 부품소재 사업부는 “원판 → 커팅 → 패턴” 수직계열화를 완료하고 원가경쟁력 확보하였으며, 공장통합 이전에 따른 생산성증대, 제반 관리비용 감소, 고객관계 강화에 집중하여 30%⁽¹⁾이상의 높은 M/S를 확보하고 있습니다.

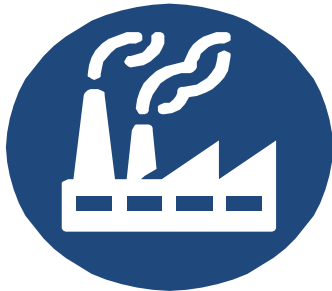


(1) 삼성전자(전세계) 도광판 수요에 대한 당사의 공급비중('21년 현재)

3. 사업경쟁력

경쟁업체 대비 사업경쟁력 우위 확보

일관생산공정



- 제일모직 압출사업부 인수
- Laser & R/S 패턴 동시생산체제
- One Stop 생산으로 원가경쟁력 확보

기술력



- MS, PMMA Fine Lenti 압출기술
- 정밀 경면 가공 기술
- Laser 패턴 설계 및 가공 기술
- R/S 패턴 설계 및 가공 기술

글로벌 고객사



- 국내외 다양한 거래처 확보를 통한 안정적인 매출 성장 지속
- 신규 해외거래선 확보를 위한 글로벌 영업 강화



1. Company Overview
2. 장비 사업 부문
3. 부품 소재 사업 부문
4. 재무현황 및 참고자료

1. 주요 재무현황(별도 재무제표)

재무제표 및 지표

(단위: 백만원,%)

	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	285,224	250,911	223,722	243,263	144,418
영업이익	47,978	7,391	852	8,055	-19,698
%매출액	16.8%	2.9%	0.4%	3.3%	-13.6%
감가상각비	6,353	8,002	8,869	8,902	6,576
EBITDA	54,331	15,394	9,722	16,957	-13,122
%매출액	19.0%	6.1%	4.3%	7.0%	-9.1%
당기순이익	37,781	6,085	1,816	5,157	-9,570
현금 및 단기금융상품	74,225	27,077	23,697	33,119	32,001
유형자산	41,718	37,515	36,354	30,975	35,699
총자산	200,162	198,300	228,286	213,831	239,428
차입금	7,493	14,457	17,879	17,127	13,706
총부채	44,064	44,343	72,293	54,129	84,199
총자본	156,097	153,956	155,993	159,702	155,228
ROE	24.2%	4.0%	1.2%	3.2%	-6.2%
ROA	18.9%	3.1%	0.8%	2.4%	-4.0%
부채비율	28.2%	28.8%	46.3%	33.9%	54.2%
이자비용	291	251	318	242	789
EBITDA이자보상배수	187x	61x	31x	70x	-17x

2. 배당 실적

	단위	2016	2017	2018	2019	2020	2021
주당 배당금	원	30	40	20	20	20	20
연말 1주간 평균주가	원	5,063	3,475	2,996	2,995	2,187	2,670
시가배당률	%	0.6%	1.2%	0.7%	0.7%	0.9%	0.7%
당기순이익	백만원	29,385	37,781	6,085	1,816	5,157	-9,570
총배당금액	백만원	2,274	3,105	1,539	1,539	1,523	1,523
배당성향	%	7.7%	8.2%	25.3%	84.7%	29.5%	-15.9%
주당순이익	원	388	490	79	24	68	-126

End of Document